

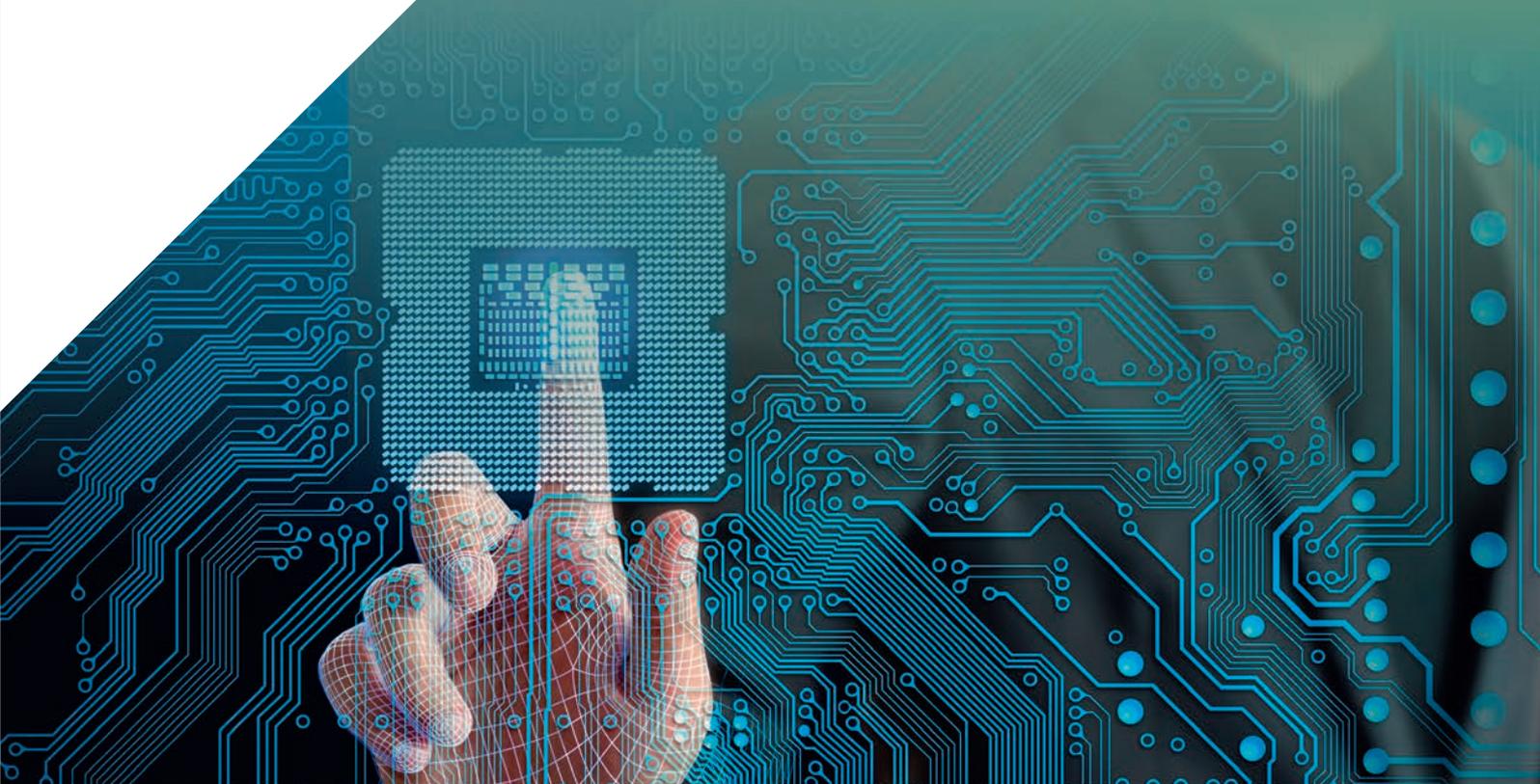
# FED

Fachverband für Design,  
Leiterplatten- & Elektronikfertigung

## 26. FED-Konferenz

27./28. September 2018  
Bamberg

## Design- und Fertigungsprozesse für smarte Elektronik



Mit freundlicher Unterstützung von:



---

# Raum für Weiterbildung und Vernetzung

Komplex, sparsam, nachhaltig, vernetzt, intelligent .... – smarte Elektronik hat viele Eigenschaften. Die Leistungen an der Grenze des technisch Machbaren unter Zeit- und Kostendruck zu entwickeln und zu fertigen, fordert uns jeden Tag aufs Neue.

Diese Entwicklung, oder bildhaft gesprochen, den Wind, können wir nicht ändern. Aber wir können die Segel richtig setzen. Sie dabei zu unterstützen, ist unsere Mission.

Die FED-Konferenz bietet den Raum. An zwei Tagen haben Sie die Möglichkeit, sich aus erster Hand zu informieren, Wissen und Erfahrungen auszutauschen, wertvolle Kontakte auch über Branchengrenzen hinweg zu knüpfen.

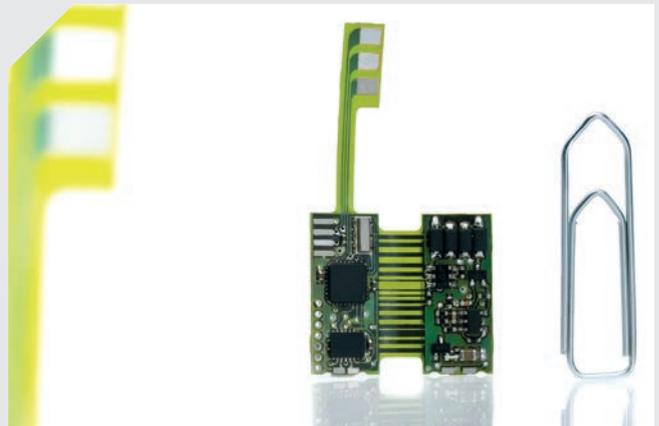
In verschiedenen Blöcken bieten wir Fachvorträge und Diskussionsrunden für Leiterplattendesigner und Experten in der Fertigung. Speziell an Entscheider richten sich Impulsvorträge von Managementprofis, IT-Experten und Juristen.

Ein Block bearbeitet das riesige Gebiet der dreidimensionalen Aufbau- und Verbindungstechnik und multifunktionalen Leiterplatten aus der Sicht der Anwender. Sehens- und hörensenswert sind unsere Keynotes: Am ersten Konferenztag nordet uns Spitzenforscher Professor Sami Haddadin auf Robotik und künstliche Intelligenz ein. Am zweiten Tag gehen wir bei Pilot und Managementcoach Peter Brandl an Bord.

Unser Rahmenprogramm startet mit einer Stadtführung durch Bamberg, dessen Altstadt gerade das 25-jährige Jubiläum Unesco Welterbe feiert. Danach können Sie auf dem Festabend Energie tanken, netzwerken und die Verleihung des PCB Design Awards an die besten Leiterplattendesigner miterleben.

Wir bieten den Raum. Nehmen Sie sich die Zeit!

Ihr  
Prof. Dr. Rainer Thüringer  
Vorsitzender des FED-Vorstandes



---

## Multifunktional und dreidimensional

Um multifunktionale Leiterplatten und dreidimensionale Aufbau- und Verbindungstechnik dreht sich (fast) alles auf der 26. FED-Konferenz. Erst diese Konstruktionen machen smarte und leichte Elektronik möglich. Sie vergrößern die Packungsdichte, reduzieren das Gewicht, erhöhen die Zuverlässigkeit und bieten neue gestalterische Freiheiten.

Multiboard, Embedding, Flex- und Starrflex-Leiterplatte oder MID unterscheiden sich im Konzept, in ihren technischen Eigenschaften und in ihren konstruktiven Vorteilen und Grenzen. Mit dem Wissen um Aufbau, Eigenschaften und Möglichkeiten können Entwickler die funktional, fertigungstechnisch und kostenseitig beste Lösung für ihr Projekt auswählen.

Hilfe bietet auch der FED-Arbeitskreis 3D-Elektronik (AK 3D). Der Arbeitskreis sammelt, analysiert und gliedert die Vielfalt der Technologievarianten systematisch und praxisnah. Zur Fachkreisarbeit gehören CAD-Systeme und Datenformate. Denn bei allen Möglichkeiten der 3D-Elektronik stellt sich eine zentrale Frage: Wie unterstützen unsere EDA-Werkzeuge diese Funktionen? Die vom AK 3D moderierte Diskussionsrunde gibt Antwort.

Wie bei allen Schaltungsträgern gilt erst recht für 3D-Elektronik: Die Gesamtsystemkosten lassen sich nur dann niedrig halten, wenn die konstruktiven Möglichkeiten und Eigenschaften optimal genutzt werden. Das funktioniert nur, wenn Entwicklung und Fertigung früh und eng zusammenarbeiten. Beispiele zeigen die Vorträge und Exponate.

Einen Blick in das weite Feld der gedruckten organischen Elektronik gibt otego. Das Startup bedruckt Folien im Rolle-zu-Rollen-Verfahren und faltet sie zu einem zentimetergroßen Würfel. Anwendungsgebiet der thermoelektrischen Generatoren ist der riesige Markt des Energy Harvesting.

Was beim 3D-Druck von Elektronik schon heute möglich ist, zeigt das Fraunhofer IZM. Außerdem schauen wir in die Zukunft auf eine Leiterplattenfertigung 2030. Zuvor starten wir in der Nanowelt von NanoWired. Das KlettWelding-Verfahren ermöglicht das Fügen und Kontaktieren von Halbleitern durch Zusammenpressen bei Raumtemperatur.

# Donnerstag, 27. September 2018

ab 08:00

**Anmeldung und Besuch der Ausstellung**

08:30

**Eröffnung der Konferenz und Begrüßung**

Prof. Dr. Rainer Thüringer, Vorstandsvorsitzender des FED

08:40

**Keynote: Künstliche Intelligenz in der Fertigung**

Prof. Dr.-Ing. Sami Haddadin, Roboterforscher und Experte für künstliche Intelligenz

09:45

**PAUSE FÜR GESPRÄCHE UND NETZWERKEN IN DER AUSSTELLUNG**

10:30

## MANAGEMENT

**Unternehmenserfolg durch zeitgemäßen B2B-Vertrieb: Vertriebsexzellenz für den Mittelstand**

Holger Steitz  
Verkaufstrainer

## ENTWICKLUNG & DESIGN

**HDI kostengünstig einsetzen: Wie das Design die Kosten beeinflusst und Kostentreiber eliminiert werden**

Harald Antonitsch  
AT&S

## FERTIGUNG & TEST

**RFID im PCB: Smarte Leiterplatten mit eingebetteter RFID steuern die Elektronikfertigung 4.0 – Praxisbericht**

Alexander Schmoltd  
Murata

## MULTIFUNKTIONALE LEITERPLATTEN

**Klett-Welding: elektrisches Kontaktieren von Bauteilen bei Raumtemperatur über Nanodrähte**

Olav Birlem  
NanoWired

11:15

**Social Media Marketing im B2B: nachhaltige Leadgenerierung und Recruiting**

Sanjay Sauldie  
Digital Business Consultant

**Leiterplattendokumentation vom Material bis zum Nutzen – was der Leiterplattendesigner liefern muss**

Martin Sachs  
db electronic

**Traceability in der Kleinserienfertigung: Chancen permanenter Datenerhebung und -analyse**

Andreas Kraus  
Kraus Hardware

**Massenfertigung von energieautarken thermoelektrischen Generatoren für das Energy Harvesting**

Matthias Hecht  
otego

12:00

**MITTAGSPAUSE – GESPRÄCHE UND NETZWERKEN IN DER AUSSTELLUNG**

13:15

**Führen ohne Vorgesetztenfunktion in Teams und Projekten**

Torsten Graßmeier und Theo Veltkamp, Trainer für Projektmanagement und Führung

**Modulares Multiboard Design am Beispiel Elektromobilität mit hohen Spannungen und maximaler Stromtragfähigkeit**

Ralf Brüning und Herbert Ritthaler, Zuken

**Die Chancen der Digitalisierung für zukunftssichere Baugruppenfertigung nutzen**

Jürgen Friedrich  
KurtzErsa

**Dreidimensionale Aufbau- und Verbindungstechnik auf Keramikbasis**

Dr.-Ing. Uwe Partsch  
Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS

14:00

**Methoden und Werkzeuge im Umgang mit Alltagsdruck in Beruf und Privatleben**

Dr. Wolfgang Dietrich  
Projektmanagementcoach

**Verständliche Design Rule Checks für DFM, DFA, DFT, SI und PI**

Dirk Müller  
FlowCAD

**Warum Fertigungs-ausrüster heute mit ihren Kunden entlang von Produktions-Workflows Lösungen für die smarte Fabrik entwickeln**

Oliver Kraus, ASM

**Vom Design zur geprüften 3D-Baugruppe: NPI/Industrialisierung von 3D-Elektronik**

Michael Matthes  
Wittenstein

14:45

**PAUSE FÜR ERFRISCHUNGEN, GESPRÄCHE UND BESUCH DER AUSSTELLUNG**

15:30

**Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung im BGB erhöht Haftungsrisiko in der Lieferkette**

Kai-Oliver Giesa  
Rechtsanwalt

**Hardware und Firmware agil entwickeln: Agile Hardware – aber wie? Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis**

Mario Blunk  
Blunk electronic und

Dr. Tobias Kästner  
Method Park Engineering

**Solder Limits: Updating UL Recognized PCBs for the Age of Surface Mount**

Emma Hudson  
UL

**Multiboard, Embedded, Flex-/Starrflex, MID ... Wie ist die EDA-Welt für das Design von 3D-Technologien gerüstet?**

Anbieter von EDA-Tools zeigen in Kurzpräsentationen ihre 3D-Features. Im Anschluss können alle Teilnehmer ihre Fragen in einer moderierten Diskussion an die EDA-Experten richten.

16:15

**Datenschutzrisiken für Unternehmen mit Inkrafttreten der DSGVO**

Ralf Wickert  
Rechtsanwalt

**Die neue UL: Konsequenzen für Leiterplattenhersteller und Baugruppenfertiger**

Diskussionsleiter:  
Jürgen Deutschmann, AT&S

17:00

17:30

**Geführte Tour durch die Bamberger Altstadt – Motto: Faszination Weltkulturerbe**

19:30

**Empfang und Einlass zur Abendveranstaltung**

20:00

**Abendveranstaltung im Hegel-Saal mit der Verleihung des PCB Design Awards**

# Freitag, 28. September 2018

ab 08:00

**Anmeldung und Besuch der Ausstellung**

08:30

**Eröffnung des zweiten Konferenztages**  
Prof. Dr. Rainer Thüringer, Vorstandsvorsitzender des FED

08:40

**Hurricane Management – Schubhebel für die Unternehmenskultur im 21. Jahrhundert**  
Peter Brandl, Berufspilot, Fluglehrer, Managementberater

09:45

**PAUSE FÜR GESPRÄCHE UND NETZWERKEN IN DER AUSSTELLUNG**

10:30

**MANAGEMENT**  
**Die Chancen von Digitalisierung und Standardisierung für deutsche Fertiger von Musterbaugruppen**  
Jan Marloth, Becktronic und Felix Blitzko, AISLER

**ENTWICKLUNG & DESIGN**  
**Hardware für das Internet der Dinge (IoT) – vernetzte Geräte, Sensoren und Adapter: die Anforderungen an Designs zum Erfassen von Daten und deren sichere Übermittlung**  
N.N.

**FERTIGUNG & TEST**  
**Prozessanforderungen für die Verarbeitung von Bauteilen mit 250 µm Pitch**  
Rainer Taube  
TAUBE ELECTRONIC

**MULTIFUNKTIONALE LEITERPLATTEN**  
**Embedding von HF-Komponenten für hochgenaue HF-Antennen**  
Thomas Gottwald  
Schweizer Electronic

11:15

**IT-Sicherheit für die digitale Industrie: ganzheitliche Ansätze für KMU**  
Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie SIT

**Entwicklung ganzheitlicher Systemlösungen und zukünftige Anforderungen an Industriedisplays und MMI**  
Patrick von Unold  
Data Modul

**IPC-A-600 / IPC-A-610 - Fehlerbilder aus der täglichen Praxis der Leiterplattenanalyse**  
Thomas Kuhn  
HTV

**SMD-Embedding für kleine und mittlere Stückzahlen am Beispiel eines 8-Kanal-Multiplexers**  
Johannes Blum  
ILFA

12:00

**MITTAGSPAUSE – GESPRÄCHE UND NETZWERKEN IN DER AUSSTELLUNG**

13:15

**Die Chancen verzahnter IT-Systeme und Automatisierung der Lieferkette für Baugruppenkalkulation und Angebotserstellung, Bauteilebeschaffung und Stammdatenpflege sowie der Umgang mit Bauteilverfügbarkeit und Allokation**  
Statements und Diskussion:  
Thomas Kaiser, CCS  
Dr. Marc Schacherer, Farnell  
Dirk Müller, FlowCAD  
Carmen Escherich, Bay-Soft

**Design for Reliability oder wie kann der Entwickler die Leiterplattenzuverlässigkeit beeinflussen**  
Helge Schimanski  
Fraunhofer ISIT

**Void und Lunker und deren Einfluss auf die Lebensdauer RoHS-konformer Lötverbindungen**  
Lutz Bruderreck  
TechnoLab

**Die Zukunft der Leiterplatte: integrierte Funktionen, neue Materialien, Marktzyklen, disruptive Einflüsse**  
Mark Nikutowski  
NCAB Group

14:00

**Design for Inspectability: Empfehlungen für die 100%ige Inspizierbarkeit von Baugruppen**  
Michael Mügge  
Viscom

**Einflussfaktoren im SMD-Prozess und die Wahrscheinlichkeit der Bildung von Voids und Lunkern**  
Dr.-Ing. Heinz Wohlrabe  
TU Dresden

**Dreidimensionale Elektronikmodule: ressourcenschonende Fertigung individualisierbarer Produkte**  
Ulf Oestermann  
Fraunhofer IZM

14:45

**PAUSE FÜR ERFRISCHUNGEN, GESPRÄCHE UND BESUCH DER AUSSTELLUNG**

15:15

**Wertstromorientiertes Prozessmanagement und Materialfluss: Durchlaufzeiten reduzieren, Umlaufbestände senken, transparente Fertigung – Praxisbeispiel**  
N.N.

**Aktive Stücklisten und verknüpfte Dokumentation für Qualität, Genauigkeit und Umsetzbarkeit**  
Christian Keller  
Altium

**Neues Prüfverfahren vermeidet „Fake Tests“ und garantiert die Qualität von Testprogrammen**  
Hans Baka  
Digitaltest

**IML SmartWave Panels: dreidimensional geformte Kunststoffbauteile mit integrierter Elektronik**  
Christoph Ernst  
Kunststoff Helmbrechts

16:00

**Optimieren der Baugruppenentwicklung durch Verringerung des Time-to-Market**  
Jens Arnold  
bflex electronic

**Automatisierte Leiterplatten-Kriechstromanalyse in 2D und 3D**  
Minoru Ishikawa und Rory Riggs, Mentor

**Optimierte Handbestückung unter Einsatz einer Datenbrille – Praxisbericht zum BMBF-Projekt OptED**  
Jeannine Budelmann  
Budelmann Elektronik

**Neue Ansätze zur Herstellung mechatronischer Module**  
Prof. Dr. Herbert Reichel, Hochschule Hof, und Prof. Dr. Marcus Reichenberger, TH Nürnberg

16:40

16:45

**Verabschiedung der Konferenzteilnehmer in der Ausstellung und Ausblick 2019**  
Prof. Dr. Rainer Thüringer, Vorstandsvorsitzender des FED

---

# Keynotes

---

## Die nächste Stufe der Werkzeuge nach dem Computer

**Prof. Dr.-Ing. Sami Haddadin**

Roboter montieren, applizieren und transportieren Bauteile stoisch und mit kantigen Bewegungen in geschlossenen Arealen der Fertigungen. Prof. Dr.-Ing. Sami Haddadin, Professor für Robotik und Systemintelligenz der TU München und Gründungsdirektor der Munich School of Robotics and Machine Intelligence ist überzeugt: „In Zukunft können Roboter selbstständig handeln.“

Diese neue Generation von maschinellen Assistenten wird in die digitalen Fabriken einziehen und das Werkpersonal unterstützen oder Hand in Hand mit ihm arbeiten. Haddadin demonstriert das an einem intelligenten lernfähigen Roboterassistenzsystem. Hierfür wurden er und sein Team mit dem Deutschen Zukunftspreis 2017 des Bundespräsidenten ausgezeichnet. Die neue Robotergeneration besteht aus leichteren Bauteilen, hat einen Tastsinn und imitiert menschliche Bewegungen. Die Automaten lernen, indem sie nachahmen und sich Abläufe merken.

„Robotik und künstliche Intelligenz werden unsere Welt grundlegend verändern wie nur wenige Technologien vor ihr“, sagt der Spitzenforscher, der die Keynote des ersten Konferenztages hält.



DO  
27.09.2018  
08:40 UHR

---

## Schubhebel für die Unternehmenskultur im 21. Jahrhundert

**Peter Brandl**

Die Daten der Profifluffahrt beeindrucken: Trotz schwieriger Rahmenbedingungen und hochkomplexer Systeme ist das Flugzeug seit langem das sicherste Verkehrsmittel. Selten passieren in der Luftfahrt Fehler aufgrund mangelnder Technik. In über 80 Prozent liegt die Ursache beim Menschen. „Diese menschlichen Faktoren kann man eins zu eins auf das Geschäftsleben übertragen“, sagt Peter Brandl.

Der Berufspilot und Fluglehrer zieht erstaunliche Parallelen zwischen professioneller Luftfahrt und Unternehmensalltag. Locker und unterhaltsam projiziert der Kommunikationsprofi seine Erfahrungen aus der Fliegerei auf Führung und Kommunikation im Unternehmen. Mit Leidenschaft und mitreißender Rhetorik erklärt der mehrfache Autor und Redner, wie wir die Strategien der Profipiloten auf die Kommunikation in unseren Teams übertragen können.

Das Management der Zukunft baut auf Kommunikation. Was braucht unser Projekt, was brauchen unsere Mitarbeiter, um eine Erfolgsstory zu schreiben? Wie sollten wir im 21. Jahrhundert mit Fehlern umgehen? Boarding für den 60-Minuten-Flug mit Peter Brandl ist am zweiten Konferenztage.



FR  
28.09.2018  
08:40 UHR

---

# Tagungsort und Abendveranstaltung

Das Welcome Kongress Hotel Bamberg liegt am Ufer der Regnitz in unmittelbarer Nähe zur Altstadt Bamberg. Diese wartet mit dem größten, unversehrt erhaltenen historischen Stadtkern in Deutschland auf. Seit 1993 ist Bamberg als Weltkulturerbe in der Liste der UNESCO eingetragen.

Nach dem ersten Kongresstag können Sie die Sehenswürdigkeiten Bambergs bei einer Stadtführung entdecken. Danach laden wir Sie ein zur Abendveranstaltung in den Hegel-Saal der benachbarten Konzert- und Kongresshalle. In festlicher Atmosphäre, bei gutem Essen und umrahmt von einem Unterhaltungsprogramm haben Sie Gelegenheit, abseits vom Tagesgeschäft Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen. Der Höhepunkt in diesem Jahr: Die Verleihung des PCB Design Awards 2018.

## **Welcome Kongresshotel Bamberg**

Mußstraße 7  
96047 Bamberg  
Tel: +49 951 7000-0  
info.bak@welcomehotels.com

---

# Anreise und Übernachtung

Für Konferenzteilnehmer, die mit dem Auto anreisen, bietet das Hotel eine große Tiefgarage mit kostenpflichtigen Parkplätzen. Bitte nehmen Sie ihre Zimmerreservierung selbst vor. Die Kosten für die Übernachtung tragen die Konferenzteilnehmer. Für die Übernachtung in Bamberg haben wir eine Auswahl an Hotels auf der Internetseite der FED-Konferenz ([www.fedkonferenz.de](http://www.fedkonferenz.de)) zusammengestellt. Unter dem Stichwort FED sind Kontingente eingerichtet. Bitte reservieren Sie Ihre Zimmer so früh wie möglich. Die Kontingente verfallen ab Juli/August 2018. Weitere Übernachtungsmöglichkeiten und Veranstaltungsangebote in Bamberg finden Sie im Internet unter [www.bamberg.info](http://www.bamberg.info).

---

# Kontakt

## **FED e. V.**

Frankfurter Allee 73C  
10247 Berlin  
Tel. +49 30 340 60 30 50  
Fax +49 30 340 60 30 61  
[www.fedkonferenz.de](http://www.fedkonferenz.de)  
[konferenz@fed.de](mailto:konferenz@fed.de)



## PCB DESIGN AWARD

### Siegerehrung beim Wettstreit der Leiterplattendesigner

Fachleute sind sich einig: „Die Intelligenz sitzt vor dem Bildschirm.“ Um diese Intelligenz – die Leistung des Leiterplattendesigners – geht es beim PCB Design Award. Darum steht bei diesem Wettbewerb nicht das Produkt im Mittelpunkt, für das eine Baugruppe entwickelt wurde. Entscheidend beim PCB Design Award sind die Aufgabe und Randbedingungen, die an den Designer gestellt wurden und wie er diese gelöst hat.

Aufgerufen waren alle Leiterplattendesigner in Deutschland, der Schweiz und Österreich, eine Arbeit aus ihrer Berufspraxis einzureichen. An dieser Arbeit sollten die PCB-Designer die an sie gestellte Aufgabe und Lösung beschreiben und mit Detailbildern und Fotos der Baugruppe veranschaulichen. Eine sechsköpfige Fachjury nahm die Bewertungen vor – nach technischem Anspruch, Fertigbarkeit und Dokumentation – unabhängig, streng vertraulich und anonym.

Seit 2012 verleiht der FED alle zwei Jahre den wertvollen Berufspreis, der als Ritterschlag in der Community gilt. Wer in diesem Jahr zu den besten PCB-Designern gehört, erfahren wir bei der Siegerehrung auf dem Festabend.



## AUSSTELLUNG

### Zeit und Raum zum Diskutieren und Netzwerken

Die FED-Konferenz ist die einzige deutschsprachige Veranstaltung, die den gesamten Entwicklungs- und Fertigungsprozess von elektronischen Baugruppen und Mikrosystemen in der Praxis der beteiligten Unternehmen umfasst. Seit 25 Jahren bringt die zweitägige Konferenz Fachleute aus der Industrie und angewandten Forschung zum Wissens- und Erfahrungsaustausch zusammen. Die bewährte Plattform ermöglicht den Teilnehmern, aktuelle Entwicklungen kennenzulernen und einzuordnen und die Weichen rechtzeitig zu stellen.

Eine begleitende Ausstellung an beiden Konferenztagen bietet Raum und Zeit zum Informieren, Diskutieren und Netzwerken. Die Ausstellung befindet sich im Mittelpunkt des Veranstaltungsbereichs mit direktem Zugang zu den Vortragsräumen. Auf 760 Quadratmetern präsentieren sich Designdienstleister, Leiterplattenexperten, EMS-Firmen, Software-Anbieter und Zulieferer für die Elektronikfertigung.

Anmeldungen zur Ausstellung sind noch möglich. Bitte beachten Sie: Die Ausstellung ist sehr beliebt und die Anzahl der Ausstellungsplätze begrenzt. Melden Sie sich frühzeitig an!



# Anmeldung und Teilnahmegebühren

## Konferenzteilnahme (Preise in EUR, mehrwertsteuerfrei)

### Frühbucherrabatt (01, 02, 03) 10 % bis 17. Juli 2018

|    |   | FED-Mitglied | Nichtmitglied |
|----|---|--------------|---------------|
| 01 | Konferenz 1 Tag am Do, 27.09.2018 inkl. Abendveranstaltung              | 490          | 710           |
| 02 | Konferenz 1 Tag am Fr, 28.09.2018                                       | 490          | 710           |
| 03 | Konferenz 2 Tage, 27. und 28.09.2018 inkl. Abendveranstaltung           | 850          | 1.200         |
| 04 | Begleitperson Festabend, 27.09.2018 ab 19:30 Uhr im Hegel-Saal, Bamberg | 70           | 100           |

In den Teilnahmegebühren (01, 02, 03) sind enthalten: Konferenzteilnahme (Keynotes, Vorträge, Fachausstellung), Tagungsmappe, Mittagessen, Pausensnacks, Pausengetränke, 01 und 03 inkl. Abendveranstaltung am 27.09.2018

## Firmenausstellung (Preise in EUR zzgl. MwSt.)

|    |   | FED-Mitglied | Nichtmitglied |
|----|---|--------------|---------------|
| A1 | <b>Aussteller Premium 2 Tage, 27. und 28.09.2018</b><br>freie Platzwahl lt. Ausstellerplan, Stand B 3,00 m x T 2,00 m, 2 Standbetreuer<br>inkl. Konferenzteilnahme (03), 1 Tisch, 2 Stühle, Werbepaket (P1, P3, P4) | 3.690        | 5.490         |
| A2 | <b>Aussteller Classic 2 Tage, 27. und 28.09.2018</b><br>Stand B 3,00 m x T 2,00 m, 1 Standbetreuer inkl. Konferenzteilnahme (03), 1 Tisch, 2 Stühle   | 1.690        | 2.490         |
| A3 | <b>zusätzlicher Standbetreuer inkl. Konferenzteilnahme (03)</b>   | 690          | 990           |

## Werbe-/Sponsoringleistungen (Preise in EUR zzgl. MwSt.)

|    |   | FED-Mitglied | Nichtmitglied |
|----|---|--------------|---------------|
| P1 | Logo Webseite 26. FED-Konferenz mit Link zur Unternehmenswebsite                  | 480          | 650           |
| P3 | Logo Titelseite Konferenzprogrammheft (Größe ca. 30 x 20mm), ca. 64-seitig        | 370          | 490           |
| P4 | Anzeige Konferenzprogrammheft (Größe, ganzseitig ca. 180 x 260 mm), ca. 64-seitig | 600          | 900           |

Werden Sie Sponsor für Tagungsmappen mit Ihrem Logo! Bitte sprechen Sie uns an (Mail an [konferenz@fed.de](mailto:konferenz@fed.de)).

Anmeldung und Teilnahmebedingungen  
unter [www.fedkonferenz.de](http://www.fedkonferenz.de)

